

证券代码：688120

证券简称：华海清科

华海清科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-07

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	参加“华海清科股份有限公司2023年第三季度业绩说明会”的全体投资者
时间	2023年12月6日16:00-17:00
地点	上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长、首席科学家 路新春 独立董事 管荣齐 副总经理、董事会秘书 王同庆 财务总监 王怀需
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事长介绍2023年前三季度经营业绩主要情况：</p> <p>公司2023年前三季度经营业绩再创新高，实现营业收入18.4亿元，同比增长62.37%；实现归母净利润5.64亿元，同比增长64.46%；实现归母扣非净利润为4.59亿元，同比增长72.46%。同时公司高度重视核心技术的研发和创新，持续加大研发投入，2023年前三季度研发投入达2.14亿元，同比增长50.14%。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q1：请问公司生产的超精密晶圆减薄机的订单情况，以及目前半导体新的封装技术是否会加大晶圆减薄机的用量？</p> <p>A：尊敬的投资者您好，公司12英寸超精密晶圆减薄机Versatile-GP300是业内首次实现12英寸晶圆超精密磨削和CMP全局平坦化的有机整合集成设备，已获得小批量订单，今年已有多台设备发往不同客户端进行验证。随着芯片结构3D</p>

化、Chiplet 等先进封装技术不断演进，预计减薄设备将获得更加广泛的应用，公司将继续把握市场机遇，在新领域实现突破。感谢您对公司的关注！

Q2: 请问公司北京亦庄项目何时能建成达产，以及产能是多少？会否出现产能过剩情况？

A: 尊敬的投资者您好，公司全资子公司华海清科北京在北京经济技术开发区实施“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”，用于公司开展化学机械抛光设备、减薄设备、湿法设备等高端半导体设备研发及产业化，建设周期预计为 26 个月。随着我国集成电路发展成为国家重点战略和全球贸易环境日趋复杂，对半导体专用设备的国产化需求愈发迫切且增长迅速，公司需要前瞻性地扩大生产能力来满足快速增长的市场需求，本项目将进一步扩大公司生产经营规模和提高技术研发实力，从而提升公司核心竞争力。感谢您对公司的关注！

Q3: 请问公司 CMP 设备 14nm 制程工艺验证的进展情况？以及更先进制程的研发情况？

A: 尊敬的投资者您好，公司高度重视 CMP 产品的技术和性能升级，推出了满足更多材质工艺和更先进制程要求的新功能、新模块和新产品，同时进一步加大研发投入，持续推进面向更高性能、更先进节点的 CMP 设备开发及工艺突破。感谢您对公司的关注！

Q4: 请问公司新增的关联交易是否是今年新增了订单？

A: 尊敬的投资者您好，公司新增 2023 年度日常关联交易额度主要是由于客户新增采购计划，公司将在预计额度范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。感谢您对公司的关注！

Q5: 海外成熟制程向设计厂商降价，请问国内晶圆厂商有无对公司产品有降价通知？

A: 尊敬的投资者您好，公司产品订单价格较为稳定，同

	时将持续开发新客户新产品，并通过改进工艺提升效率、降本增效等管理措施保持公司毛利水平，感谢您对公司的关注！
附件清单	无
日期	2023年12月6日